

PCB 焊工成功逆袭 AI 心脏！2024 年业绩大增 70%，中报预告再涨 50%

导语：吃下 AI 红利大蛋糕。

作者：市值风云 App：beyond

想象一下，你用的手机、电脑、甚至智能汽车，它们的“神经系统”是什么？就是印制电路板（PCB）！这玩意儿虽然不起眼，却是所有电子设备的“骨架”和“血管”。

现在，科技圈最火的是什么？AI 算力！高性能计算（HPC）！数据中心！智能汽车！可穿戴设备！这些领域像饿狼一样，疯狂渴求着更高性能、更复杂、更精密的 PCB，尤其是服务于 AI 服务器、高速交换机的那部分高端货。

为啥高端 PCB 这么吃香？

首先，AI/HPC 是“吞金兽”。训练大模型、搞高性能计算，都需要超级服务器。这些服务器里的 PCB，还要用到高密度互连这种精密技术，技术门槛高，单块板子价值蹭蹭涨。

其次，光模块在升级。网络速度从 800G 奔向 1.6T，光模块也得跟上。这要求 PCB 制造工艺更牛，比如要用到 mSAP（改良型半加成工艺），技术难度大，但附加值也高。未来还有 CPO（光电共封装）技术，有望带来更多新需求。

还有智能汽车/可穿戴设备的潜力需求，汽车里的智能大脑（域控制器）、各种传感器、车机娱乐系统，还有你手上的智能手表、耳机，都需要更轻薄、散热更强、信号传输更快的 PCB。

简而言之，低端 PCB 竞争激烈，红海一片；而高端 PCB 技术壁垒高，玩家少，集中度提升。谁有硬核技术、稳定大客户、肯砸钱研发，谁就能吃到最大块的蛋糕。

沪电股份（002463.SZ，公司），正是国内玩家里的佼佼者。

一、沪电股份：半年成绩单亮眼

说沪电股份是行业中的优等生，一点不夸张。看看它 2025 年上半年的业绩预告：归母净利润 16.5 亿元-17.5 亿元，同比增长 45%-53%；扣非净利润 16.1 亿元-17.1 亿元，同比增长 45%-54%。

2、预计的经营业绩：☐ 扭亏为盈 ☒ 同向上升 ☐ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：165,000 万元 - 175,000 万元	盈利：114,083.03 万元
	比上年同期增长：44.63% -53.40%	
扣除非经常性损 益后的净利润	盈利：161,000 万元-171,000 万元	盈利：111,147.11 万元
	比上年同期增长：44.85% -53.85%	
基本每股收益	盈利：0.86 元/股 - 0.91 元/股	盈利：0.5966 元/股

(来源：公司 2025 半年度业绩预告)

这增长势头堪称凶猛，要知道，2024 年全年沪电股份的收入同比增幅就有 49%，归母净利润同比增幅达到 71%。今年上半年，其业绩继续高歌猛进，核心驱动力来自于高端 PCB。

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	13,341,541,440	8,938,309,250	49.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,587,236,693	1,512,538,227	71.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,546,301,588	1,408,380,964	80.80%

(来源：公司 2024 年财报)

公司在 2025 年 7 月公告称，2024 年其 AI 服务器及 HPC 相关产品占比约 29.5%，这意味着 AI 算力爆发的红利，公司算稳稳接住了。

2024 年应用于 AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施等领域的企业通讯市场板实现营业收入约 100.93 亿元，其中 AI 服务器和 HPC 相关 PCB 产品约占 29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品约占 38.56%；其余主要是通用服务器、无线基础设施这些。2024 年公司汽车板整体实现营业收入约 24.08 亿元，其中公司毫米波雷达、采用 HDI 的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、P²Pack 等新兴汽车板产品约占 37.68%。

(来源：公司 2025 年 7 月公告)

而在 2025 年半年度业绩预告中，公司表示其业绩增长主要受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，和平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术。

三、业绩变动原因说明

受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，预计公司 2025 年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。

(来源：公司 2025 半年度业绩预告)

从过往来看，公司在收入端也保持了稳健增长态势。2019-2024 年，公司营收由 71 亿元增至 133 亿元，CAGR 为 13%。近两年，公司收入增长有所提速。

沪电股份 – 营收及增速

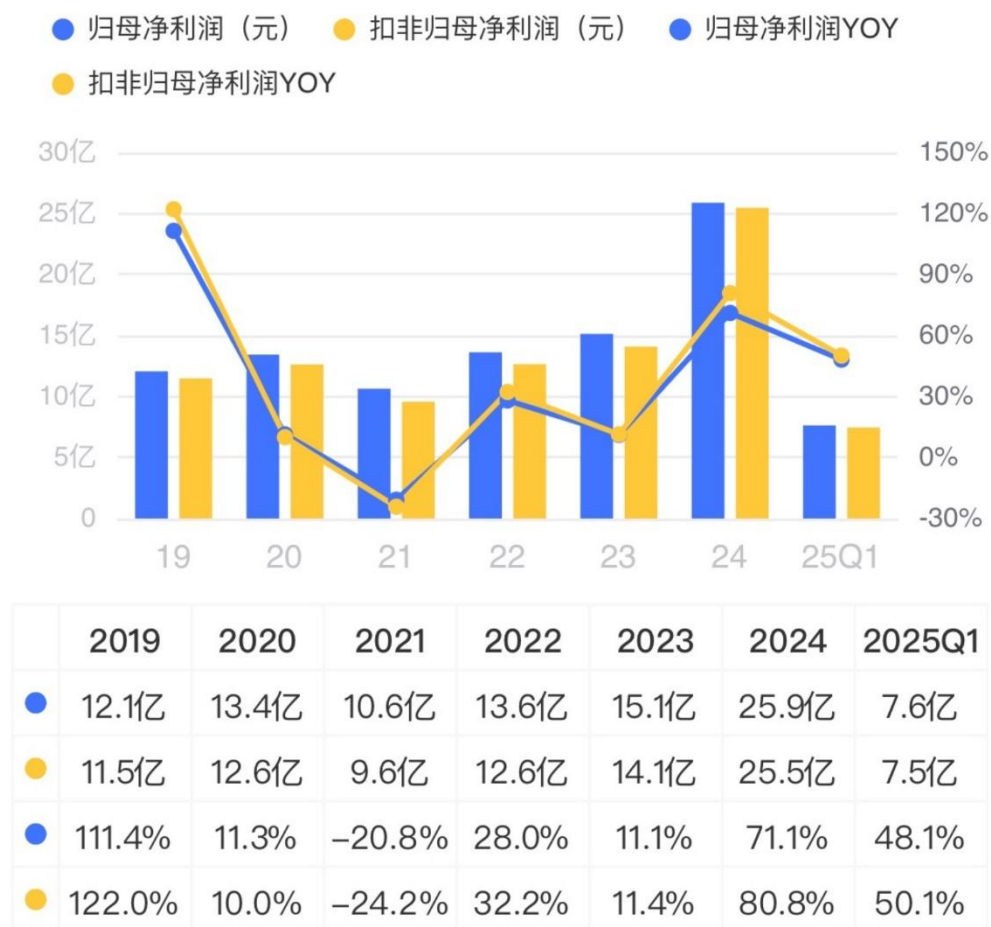
● 营业收入（元） ● 营收YOY



（来源：市值风云 APP）

盈利端,公司的归母净利润由 2019 年的 12 亿元增至 2024 年的 26 亿元,CAGR 为 16%。

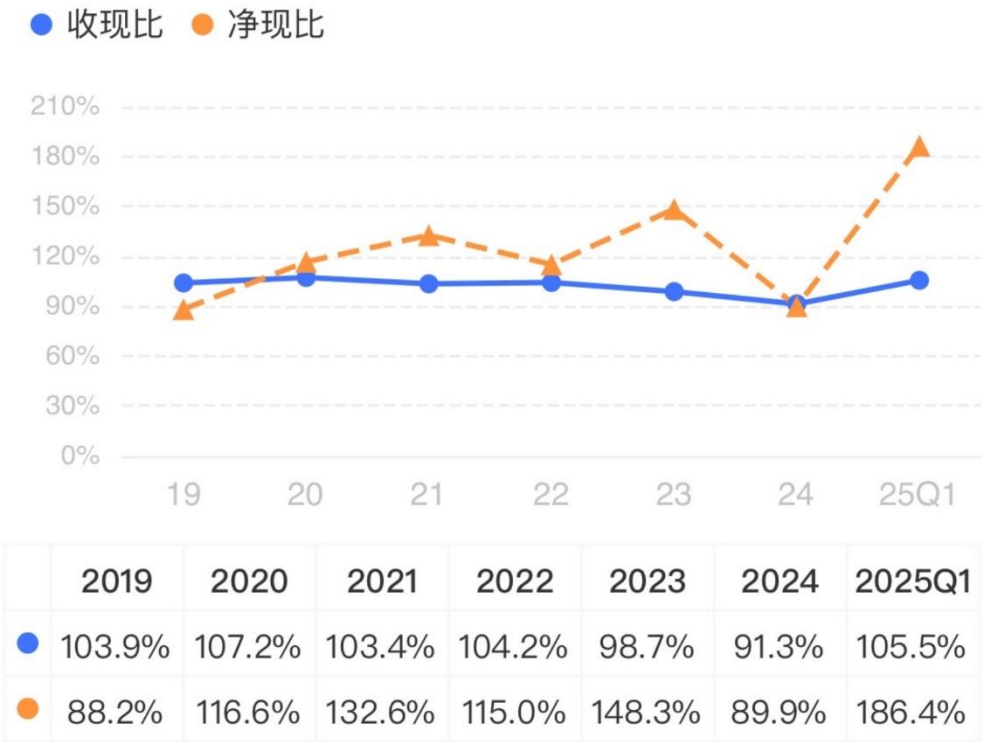
沪电股份 – 净利润



（来源：市值风云 APP）

收现比显示，公司收入增长的同时所匹配的现金含量一直较为充足。与此同时，净现比显示公司的盈利也基本都是真金白银。

沪电股份 – 收现比与净现比



(来源：市值风云 APP)

二、增长密码：沪电凭啥这么牛？

沪电股份近两年的业绩飞涨不是偶然，其手里握着这样几张“王牌”：

(一) 差异化产品绑定海外大客户

作为国内头部 PCB 企业之一，公司很早就成功打入多家国际科技巨头的供应链，尤其在 ASIC 服务器和高速交换机 PCB 领域站稳了脚跟。2024 年，公司海外收入占比达到 86.5%。

PCB 行业升级和发展主要由下游终端需求变化驱动。2024 年，数据中心中的 AI 服务器和高速网络设备是 PCB 市场的主要和关键增长动力，推动了多种 PCB 产品的成长和发展，其中 18 层以上多层板增长约 40.2%，是 PCB 市场中表现最佳的细分市场；HDI 板也因此受益增长约 18.8%。

从地域来看，由于 18 层以上多层板、基于 BT 的封装基板和 HDI 板的强劲增长，中国 PCB 市场在 2024 年增长最快。

2024/2023区域PCB产值增长率预测

产值 增长率	多层板			HDI	封装基板	柔性板	其他	总计
	4-6 层	8-16 层	18 层以上					
美洲	10.4%	10.5%	9.0%	5.7%	13.7%	6.1%	7.2%	9.0%
欧洲	-11.8%	-8.3%	3.0%	-8.8%	-3.4%	7.9%	-4.2%	-5.3%
日本	2.9%	4.0%	3.1%	10.2%	-13.2%	5.5%	1.0%	-3.9%
中国	2.1%	5.5%	67.4%	21.0%	21.2%	6.7%	3.0%	9.0%
亚洲	1.7%	1.7%	52.7%	18.6%	-0.8%	-3.2%	1.2%	3.2%
总计	2.0%	4.9%	40.2%	18.8%	0.8%	2.6%	2.4%	5.8%

(来源：公司 2024 年财报)

作为全球主要经营高速通信 PCB 板的龙头厂商，公司显著受益于这一轮 AI 所带动的 PCB 升级趋势。2024 年，公司企业通讯市场板中，AI 服务器和 HPC 相关产品占比约 29.5%，高速网络的交换机及配套设备占比约 38.6%。

2024年上半年，公司AI服务器和HPC相关PCB产品同比倍速成长；2024年下半年，高速网络的交换机及其配套路由相关PCB产品成为公司增长最快的细分领域，环比增长超90%。2024年公司企业通讯市场板营业收入中，AI服务器和HPC相关PCB产品约占29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关PCB产品约占38.56%。

(来源：公司 2024 年财报)

可以说，公司基于企业通讯市场板、高速网络的交换机相关 PCB 等主导产品的技术领先优势，及时把握住了 AI、ADAS 等在通信、汽车等领域的高端产品爆发式增长的需求，通过绑定海外大客户、推出附加值更高的产品，实现了更高的收入增长。

(二) 高研发支撑赚钱能力

2019 年以来，公司的研发费用快速增长，由 3.2 亿元增至 2024 年的 7.9 亿元。公司的研发投入方向主要集中在 HDI、超高速信号传输、高频高速材料等前沿领域。

这些技术的突破不仅提升了产品的性能，也增强了公司在高端客户中的议价能力。尤其是在人工智能、高性能计算（HPC）等新兴应用领域，高端 PCB 的需求正在快速增长，而公司凭借其技术储备和研发实力，成功抓住了这一市场机遇。

沪电股份 – 研发VS销售

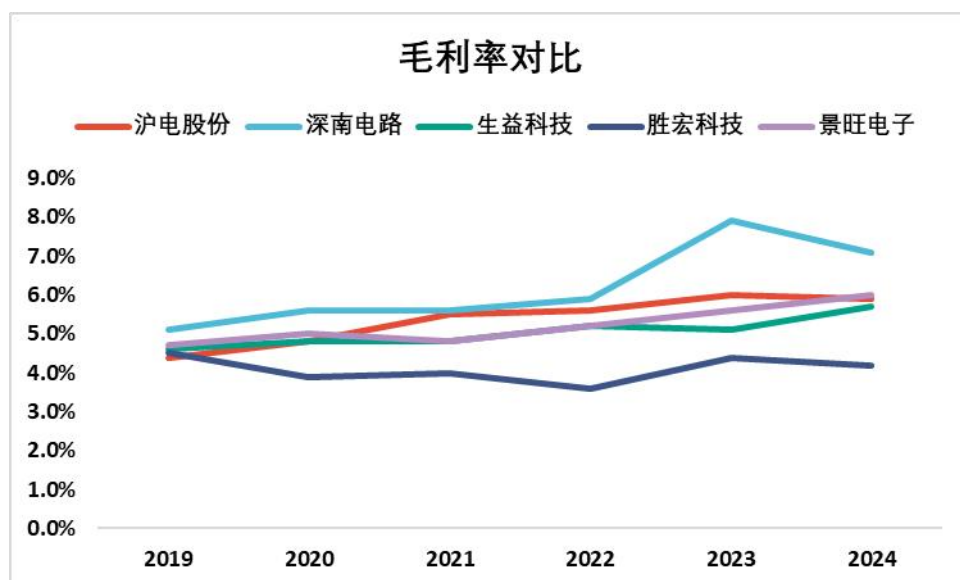
● 研发费用（元） ● 销售费用（元） ● 研发费用率 ● 销售费用率



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q1
● 研发费用（元）	3.2亿	3.6亿	4.1亿	4.7亿	5.4亿	7.9亿	2.1亿
● 销售费用（元）	2.1亿	2.3亿	2.2亿	2.7亿	2.6亿	3.7亿	1.1亿
● 研发费用率	4.4%	4.8%	5.5%	5.6%	6.0%	5.9%	5.3%
● 销售费用率	2.9%	3.1%	3.0%	3.3%	3.0%	2.7%	2.8%

（来源：市值风云 APP）

与同业可比公司对比来看，公司的研发费用率一路提高，2024 年这一指标为 5.9%，仅次于深南电路（该指标为 7.1%），沪电股份的研发费用率明显高于其他可比公司，基本处于可比公司中较高水平。

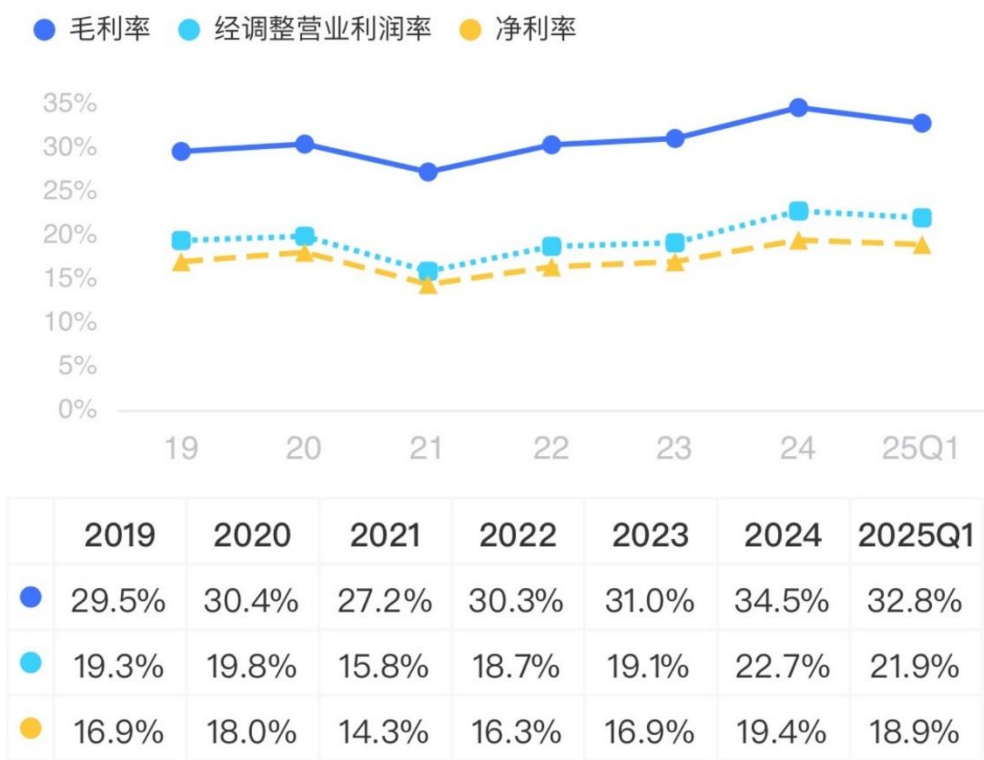


(数据来源：各企业财报)

凭借对高端 PCB 市场的布局以及对关键技术的持续攻关，以及通过优化产品结构，公司的 PCB 产品毛利率得到提升，由 2019 年的 30.4%提高至 2024 年的 35.9%。与此同时，公司的综合毛利率由 29.5%提升至 34.5%。

控费得当之后，公司的核心盈利能力——净利率，由 2019 年的 16.9%提高至 2024 年的 19.4%。

沪电股份 – 利润率



(来源：市值风云 APP)

公司通过高强度的研发投入和技术创新，不仅提升了自身的技术壁垒，也为公司带来了持续的盈利增长动力。2024 年，公司在泰国的高端 PCB 扩产项目持续推进，预计将在未来进一步释放产能，扩大高端产品市场份额。这一战略举措有助于提升其盈利能力。

(三) 扩张产能承接中长期需求

在 2024 年财报中，公司在“经营展望”重点提到将“加大投资力度.....实施一系列生产线技术改造项目，以及加快推进新建人工智能芯片配套高端 PCB 扩产项目建设”。

② 加大投资力度，兼顾短期效益与长期发展，将更多的资金投入到具有潜力和创新的领域，不断进行技术升级和创新。一方面加快实施一系列生产线技术改造项目，对瓶颈及关键制程进行迭代升级与靶向性产能扩充，提升生产效率和灵活性，根据市场需求的变化趋势调整产品结构和产能结构，以快速响应短期市场变化，更好的满足客户需求，为后续的增长积累技术和市场优势。另一方面为满足中长期市场需求，加快推进新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的建设，分阶段达成产能升级式扩容，确保企业在未来的动态环境中保持竞争力，为未来的持续发展奠定坚实基础。

(来源：公司 2024 年财报)

积极扩产的举动，体现了公司对于业务增长的信心。考虑到历史上沪电股份一直对投资扩产较为谨慎，当前大举投资 AI 配套项目，说明公司确实看好行业中长期的强劲需求。

2024 年，公司启动了总投资 43 亿元的昆山人工智能芯片配套高端 PCB 扩产项目。同时，公司还在泰国建设高端 PCB 生产基地，预计将在 2025 年进入小规模量产阶段。这些扩产举措不仅有助于缓解当前的产能紧张状况，也为公司未来的可持续发展奠定了了的基础。

从行业需求来看，2023-2028 年 AI 服务器和 HPC 相关 PCB 产品（不含载板）的复合增长率约达 40.2%，为 PCB 市场带来新的增长机遇，同时也对 PCB 企业的技术能力和创新能力提出了更高的挑战。

2023-2028年企业通讯市场板全球PCB产值年均复合增长率预测

产值单位：百万美元

应用领域	2023 年	2024 年（估算）	2028 年（预测）	2023-2028 年均复合增长率
服务器/数据存储	8,201	10,110	15,512	13.6%
其他计算机	3,661	3,757	4,039	2.0%
有线基础设施	5,955	6,213	7,826	5.6%
无线基础设施	3,118	3,115	3,674	3.3%
合计	20,935	23,195	31,051	8.2%

(来源：公司 2024 年财报)

AI 和高速网络基础设施对数据处理和传输速度要求极高，集成了多种复杂技术，如高速计算、大容量存储、高效散热等，需要在有限的空间内实现高速信号传输、高密度和高可靠性的集成。

公司的高端 PCB 扩产计划正好可以承接这一需求，确保公司在 AI 服务器和交换机市场的领先地位。

此外，新能源汽车的快速发展也推动了车用 PCB 市场的增长。2025 年，全球车用 PCB 市场规模预计将超过 300 亿美元，占整个 PCB 市场的比例从 2020 年的 12% 提升至 20%。

公司已经在毫米波雷达、HDI 自动驾驶板等高端产品领域取得突破，目前其汽车板业务占总收入的 18%。通过持续的技术升级和产能扩张，公司有望在这一快速增长的市场中进一步巩固其竞争优势。

结语

沪电股份 (002463.SZ) 的故事，是一个传统制造业龙头成功抓住科技革命浪潮、实现华丽转身的典范。

- 一、踩准了 AI 算力爆发、数据中心扩张、智能硬件普及的超级风口；
- 二、凭借深厚的高端 PCB 技术积累和先发优势，在黄金赛道中占据有利位置；
- 三、以亮眼的业绩增长和不断提升的 AI 产品占比证明了实力；
- 四、通过产能扩张计划，为未来持续增长铺平道路；

在可预见的未来，公司作为中国高端 PCB 的领军企业，有望继续受益于行业高景气度。它无疑是投资者在科技制造领域需要重点关注的“核心资产”之一。当然，持续跟踪其技术进展、产能落地情况和行业竞争格局变化也至关重要。